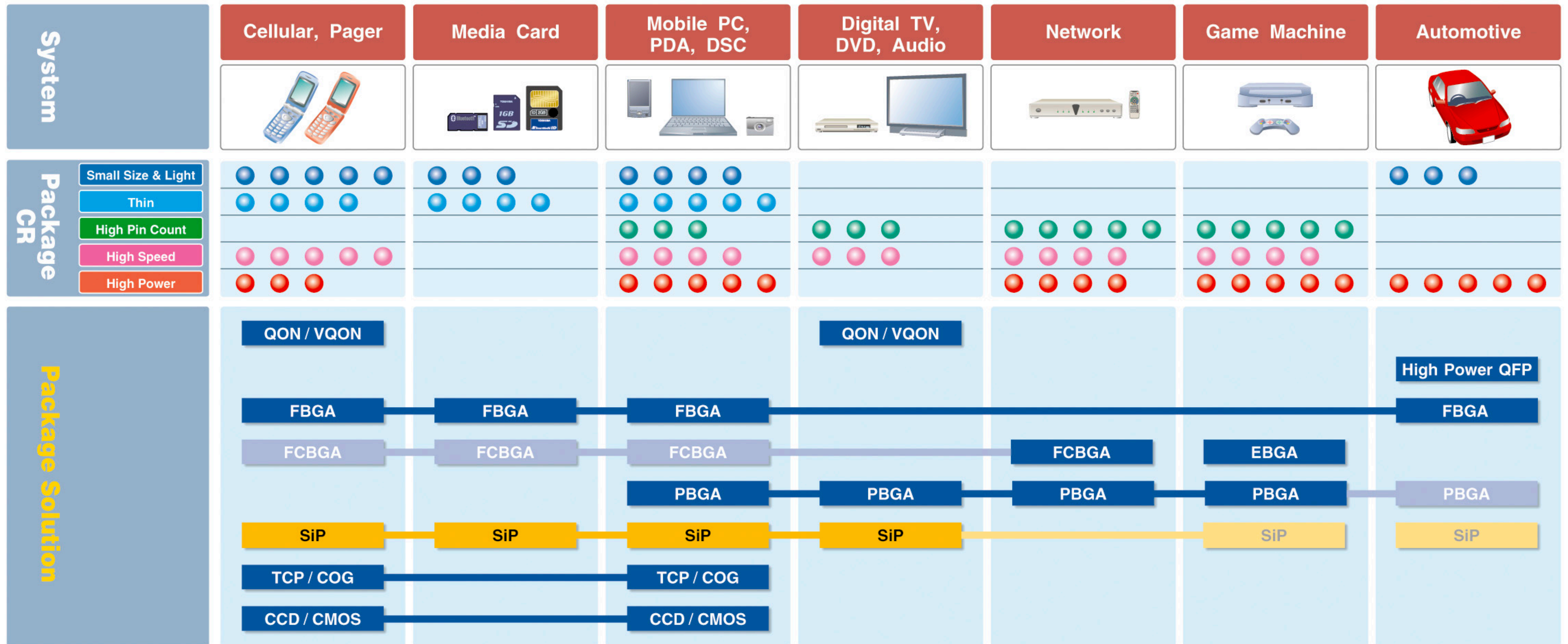


封装解决方案

Package Solutions

提供以SoC为先进技术的系统LSI中的最合适的封装解决方案

- 向每个系统提供最合适的封装解决方案
- 随着通信相关搭载零部件的增加，使得Auto Mobile领域的要求扩大
- 作为封装，FC连接的要求增加，SiP适用系统扩大



※ 记载的系统以及产品名一般都是各公司的注册商标或商标。